

# PAH300S24 - \*

## RELIABILITY DATA

### 信頼性データ

DWG.No. C175-57-01			
承認	承認	査閲	担当
<i>T. Murayama</i>	<i>S. Tanioka</i>	<i>Kawaguchi</i>	<i>K. Ishizawa</i>
10.07.03	10.07.03	9. Oct. 03	9. Oct. 03

DENSEI-LAMBDA

## I N D E X

	PAGE
1. MTBF 計算値 Calculated Values of MTBF .....	R-1
2. 部品ディレーティング Component Derating .....	R-2
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List .....	R-4
4. アブノーマル試験 Abnormal Test .....	R-5
5. 振動試験 Vibration Test .....	R-9
6. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	R-10
7. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test .....	R-12
8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test .....	R-13
9. 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test .....	R-15
10. 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test .....	R-16
11. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test .....	R-17

※ 信頼性試験は、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。  
従いまして、この値は実力値とお考え願います。

The following data are typical values. As all units have nearly the same characteristics, the data to be considered as ability values.

1. MTBF 計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : PAH300S24-28

(1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(\*1)で算出されています。  
 故障率 $\lambda_{SS}$ は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。  
 Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (\*1).  
 Individual failure rate  $\lambda_{SS}$  is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

\*1: Telcordia (Bellcore) "Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment"  
 (Document number TR-332, Issue5)

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{SSi}} \times 10^9 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{SSi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

- $\lambda_{equip}$  : 全機器故障率 (FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in $10^9$  hours)
- $\lambda_{Gi}$  :  $i$ 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the  $i$ th device
- $\pi_{Qi}$  :  $i$ 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the  $i$ th device
- $\pi_{Si}$  :  $i$ 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the  $i$ th device
- $\pi_{Ti}$  :  $i$ 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the  $i$ th device
- $m$  : 異なる部品の数 Number of different device types
- $N_i$  :  $i$ 番目の部品の個数 Quantity of  $i$ th device type
- $\pi_E$  : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

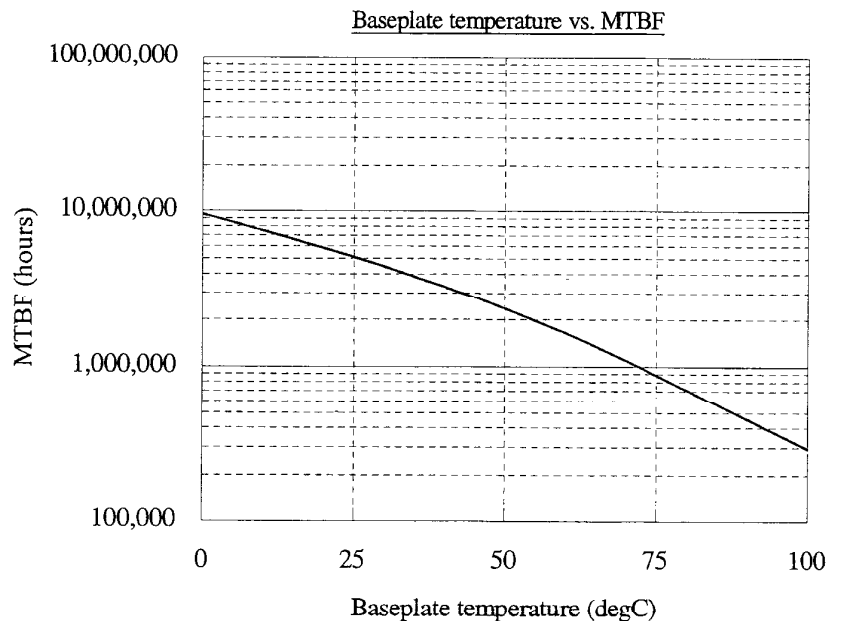
(2) MTBF値 MTBF Values

条件 Conditions :  $V_{in} = 24VDC$   
 Environment GB (Ground, Benign)

PAH300S24-28

Output current: 11A (100%)

Baseplate temperature	MTBF
25°C	5,133,191 (hours)
50°C	2,367,830 (hours)
75°C	889,242 (hours)



— PAH300S24-28 Load 100%

## 2. 部品ディレーティング Component Derating

MODEL : PAH300S24-28

### (1) 算出方法 Calculating Method

#### (a) 測定条件 Measuring Conditions

- 入力電圧 : 24VDC  
Input Voltage
- 出力電流 : 11A (100%)  
Output Current
- 取付方法 : 標準取付  
Mounting Method Standard Mounting Method
- ベースプレート温度 : 100℃  
Baseplate Temperature

#### (b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力および熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め、最大定格との比較を行いました。

The maximum rating temperature is compared with junction temperature which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

#### (c) IC、抵抗、コンデンサー等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

ベースプレート温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Baseplate temperature, operating condition, power dissipation, etc are within derating criteria.

#### (d) 熱抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-bp} = \frac{T_{j(max)} - T_{bp}}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{c(max)}}$$

$T_c$  : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25℃  
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

$T_{bp}$  : ディレーティングの始まるベースプレート温度 一般に25℃  
Baseplate Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

$T_l$  : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25℃  
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

$P_{c(max)}$  : 最大コレクタ(チャンネル)損失  
(  $P_{ch(max)}$  ) Maximum Collector(Channel) Dissipation

$T_{j(max)}$  : 最大接合点温度  
(  $T_{ch(max)}$  ) Maximum Junction(Channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  : 接合部からケースまでの熱抵抗  
(  $\theta_{ch-c}$  ) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Case

$\theta_{j-bp}$  : 接合点からベースプレートまでの熱抵抗  
Thermal Impedance between Junction and Baseplate

$\theta_{j-l}$  : 接合点からリードまでの熱抵抗  
Thermal Impedance between Junction and Lead

(2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor	備考 Note
Q1	CHIP TRANSISTOR	Tj (max): 150.0°C	Tj : 112.20°C	74.8%	
Q2	CHIP TRANSISTOR	Tj (max): 150.0°C	Tj : 112.09°C	74.7%	
Q3	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch : 112.77°C	75.2%	
Q102	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch : 126.03°C	84.0%	
Q202	CHIP TRANSISTOR	Tj (max): 150.0°C	Tj : 113.45°C	75.6%	
D103	CHIP DIODE	Tj (max): 150.0°C	Tj : 107.97°C	72.0%	
D104	CHIP DIODE	Tj (max): 150.0°C	Tj : 108.55°C	72.4%	
A1	Pri PWM IC	Tj (max): 150.0°C	Tj : 119.4°C	79.6%	

## 3. 主要部品温度上昇値

Main Components Temperature Rise  $\Delta T$  List

MODEL : PAH300S24-28

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 $\Delta T_{C-P}$ Temperature Rise(°C)
Q3	CHIP MOS FET	10.4
Q102	CHIP MOS FET	14.6
L103	CHOKE COIL	9.1
T101	TRANS.,PULSE	24.4
D103	CHIP DIODE	0.3
D104	CHIP DIODE	-0.3
	BASE-PLATE	0.0 (basis)

## ・ 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	標準取付 (放熱器有) Standard Mounting Method (with Heatsink)  $T_a = 25^\circ\text{C}$    入力側 Input  出力側 Output  21mm
入力電圧 Input Voltage	24VDC
出力電圧 Output Voltage	28VDC
出力電流 Output Current	PAH300S24-28 : 11A (100%)

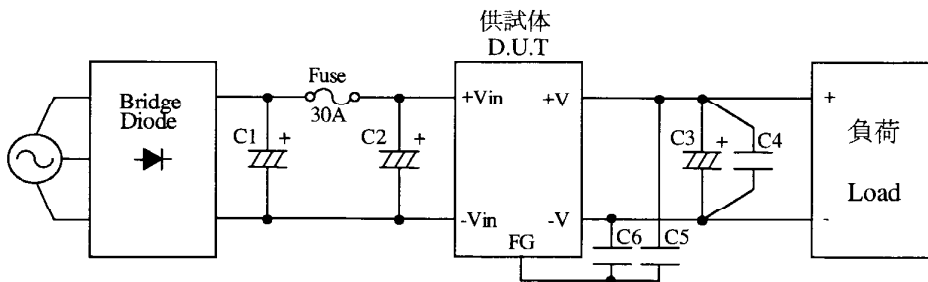
$\Delta T_{C-P}$  : 周囲温度 $25^\circ\text{C}$ においてベースプレート温度が $100^\circ\text{C}$ となる放熱器を装着し、その時のベースプレート温度を基準とした各部品の $\Delta T$  (ベースプレートと部品との温度差)を表したもの。

Temperature difference between a case of each component and base-plate, fitted power supply with heatsink to be maintained  $100^\circ\text{C}$  (base-plate temperature) at  $25^\circ\text{C}$ . (ambient temperature).

4. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : PAH300S24-28

(1) 試験条件及び回路 Test Condition and Circuit



- 入力電圧 : 36VDC
- ベースプレート温度 : 25°C
- ブリッジダイオード (D) : PGH758A
- 電解コンデンサ (C2) : 50V 220 μ F × 2para
- セラミックコンデンサ (C4) : 50V 0.1 μ F
- 出力電流 : 11A(100%)
- 使用ヒューズ : 30A
- 電解コンデンサ (C1) : 250V 15000 μ F
- 電解コンデンサ (C3) : 50V 220 μ F
- フィルムコンデンサ (C5,C6) : 250V 0.022 μ F

(2) 試験結果 Test Results

No.	試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire	So:Smoke	Bu:Burst	Se:Smell	Re:Red Hot	Da:Damaged	Fu:Fuse Blown	NO:No Output	NC:No Change	Ot:Others	備考 Note		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	Q101	G	●							●	●			●		Da:Q101,Q102	
2		S	●							●	●			●		Da:Q102	
3		D	●							●	●			●		Da:Q102	
4		D-S	●									●			●		
5		G-S	●												●		
6		D-G	●								●	●			●		Da:R3,Q101

No.	試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire		So:Smoke		Bu:Durst		Se:Smell		Re:Red Hot				
					Da:Damaged	Fu:Fuse Blown	NO:No Output	NC:No Change	Ot:Others								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒ ュー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot						
7	Q1	E		●													
8		C		●												●	効率低下 (Efficiency Down)
9		B		●													
10		B-E	●														
11		C-E	●														
12		B-C	●														
13	Q2	E		●						●	●			●			Da:Q101,Q102
14		C		●												●	効率低下 (Efficiency Down)
15		B		●						●	●			●			Da:Q101,Q102
16		B-E	●													●	効率低下 (Efficiency Down)
17		C-E	●											●			
18		B-C	●											●			
19	Q3	G		●										●			
20		S		●										●			
21		D		●										●			
22		D-S	●							●				●			Da:Q3,R30,R34
23		G-S	●											●			
24		D-G	●							●				●			Da: R30,R34
25	Q201	E		●											●		
26		C		●											●		
27		B		●											●		
28		B-E	●												●		
29		C-E	●											●			
30		B-C	●											●			
31	Q202	E		●							●			●			
32		C		●											●		
33		B		●							●			●			
34		B-E	●												●		
35		C-E	●							●						●	出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:A202,D205,Z204
36		B-C	●							●						●	出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:A202,Z204
37	Q203	E		●											●		
38		C		●											●		
39		B		●											●		
40		B-E	●												●		
41		C-E	●											●			
42		B-C	●											●			



No.	試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire	So:Smoke	Bu:Burst	Se:Smell	Re:Red Hot	Da:Damaged	Fu:Fuse Blown	NO:No Output	NC:No Change	Ot:Others			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒューズ 断 Fu	O V P	O C P	出力 断 NO	変化 なし NC	その他 Ot	
43	Q204	E		●								●		●			
44		C		●								●		●			
45		B		●									●		●		
46		B-E	●													●	
47		C-E	●													●	
48		B-C	●													●	
49	D101			●											●		
50				●											●		
51	D103			●						●							● 出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:D201,D204
52				●													● 出力電圧低下 (Output Voltage Down)
53	D104			●													● 効率低下 (Efficiency Down)
54				●									●				
55	D1			●												●	
56				●													● 出力電圧低下 (Output Voltage Down)
57	D2			●												●	
58				●												●	
59	D3			●											●		
60				●												●	
61	D4			●											●		
62				●											●		
63	D5			●											●		
64				●											●		
65	D6			●											●		
66				●											●		
67	D7			●											●		
68				●											●		
69	D201			●											●		
70				●											●		
71	D202			●											●		
72				●											●		
73	D203			●											●		
74				●											●		
75	D204			●										●			
76				●											●		
77	D205			●											●		
78				●											●		
79	Z1			●											●		
80				●										●			

試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note
部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒ ュー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot	
81	Z201		●											●		
82		●											●			
83	Z202		●											●		
84		●												●		
85	Z204		●											●		
86		●											●			
87	C101		●											●		
88		●								●			●			
89	C103		●											●		
90		●								●			●			
91	C108		●											●		
92		●										●				
93	L101		●										●			
94		●												●		
95	L103		●										●			
96		●													●	出力電圧低下 (Output Voltage Down)
97	L1		●										●			
98		●											●			
99	T101	1,2	●										●			
100		3,4	●						●						●	出力電圧低下 (Output Voltage Down) Da:D201,D204
101		1-3	●												●	効率低下 (Efficiency down)
102		1-4	●												●	出力電圧低下 (Output Voltage Down)
103		2-3	●												●	効率低下 (Efficiency down)
104		2-4	●												●	出力電圧低下 (Output Voltage Down)
105	T102	2,3	●											●		
106		7,8	●										●			
107		2-3	●											●		
108		7-8	●											●		
109		2-7	●											●		
110		2-8	●											●		
111		3-7	●											●		
112		3-8	●											●		
113	入力逆接続 Inverse Input Connection									●						

5. 振動試験 Vibration Test

MODEL : PAH300S24-28

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency Variable Endurance Test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株) 制御部 F-400-BM-DCS-7800 加振部 905-FN  
 EMIC CORP. Controller Vibrator

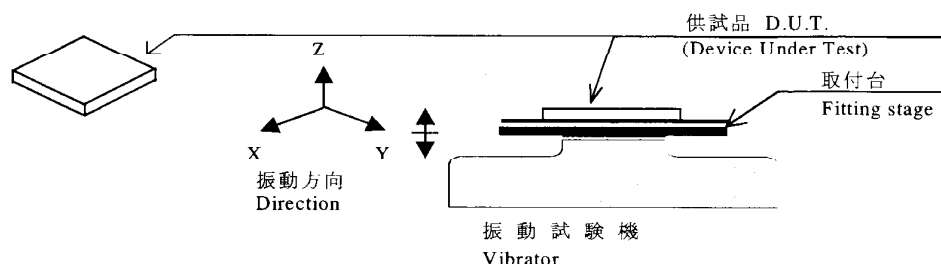
(3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

(4) 試験条件 Test Conditions

- ・ 周波数範囲 Sweep Frequency 10~55Hz
- ・ 掃引時間 Sweep Time 1分間 1 min.
- ・ 振幅 Amplitude 一定 (0.825mm) const.
- ・ 振幅方向 Direction X, Y, Z
- ・ 試験時間 Test Time 1 時間 1 hour each

(5) 試験方法 Test Method



供試品をネジ(M3)で取付台に固定する。  
 Fix the D.U.T. on the fitting-stage by M3 screw.

(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

・ 試験条件 Test Conditions

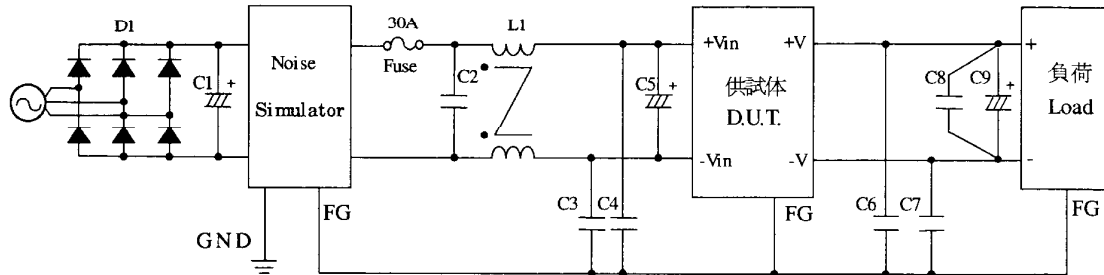
入力電圧 : 24VDC 出力電流 : 11A(100%) ベースプレート温度 : 25℃  
 Input Voltage Output Current Base-Plate Temperature

測定確認項目 Check Item	出力電圧 (V) Output Voltage	リップル電圧 (mVp-p) Ripple Voltage	機構・実装状態 D.U.T. State	
試験前 Before Test	28.082	158.5	異常なし OK	
試験後 After Test	X	28.087	159.5	異常なし OK
	Y	28.085	161.0	異常なし OK
	Z	28.082	162.5	異常なし OK

## 6. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : PAH300S24-\*

## (1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



- ノイズシミュレーター Noise Simulator : INS-4420 (ノイズ研究所)  
(NoiseLaboratoryCo.,LTD.)
- ブリッジダイオード (D1) Bridge Rectifier : PGH758A (日本インター)  
(NIHON INTER)
- 電解コンデンサ (C1) Electrolytic Cap. : 250V 15000  $\mu$ F
- セラミックコンデンサ (C2) Ceramic Cap. : 100V 10  $\mu$ F
- フィルムコンデンサ (C3,C4) Film Cap. : 275V 0.47  $\mu$ F
- 電解コンデンサ (C5) Electrolytic Cap. : 50V 820  $\mu$ F  $\times$  5para
- フィルムコンデンサ (C6,C7) Film Cap. : 250V 0.022  $\mu$ F
- セラミックコンデンサ (C8) Ceramic Cap. : 50V 0.1  $\mu$ F
- 電解コンデンサ (C9) Electrolytic Cap. : 12V : 25V 470  $\mu$ F  
28V : 50V 220  $\mu$ F
- コモンモードチョークコイル(L1) Common-Mode Choke Coil : 1mH

(2) 試験条件 Test Conditions

- |                        |               |                   |                |
|------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| ・入力電圧                  | : 24VDC       | ・ノイズ電圧            | : 0~2.0kV      |
| Input Voltage          |               | Noise Level       |                |
| ・出力電圧                  | : 定格          | ・極性               | : +, -         |
| Output Voltage         | Rated         | Polarity          |                |
| ・出力電流                  | : 100%        | ・モード              | : ノーマル、コモン     |
| Output Current         |               | Mode              | Normal, Common |
| ・ベースプレート温度             | : 25℃         | ・トリガ周波数           | : 20Hz~62.5Hz  |
| Base-Plate Temperature |               | Trigger Frequency |                |
| ・パルス幅                  | : 50ns~1000ns |                   |                |
| Pulse Width            |               |                   |                |

(3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PAH300S24-12 : 1台 (unit)      PAH300S24-28 : 1台 (unit)

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1.破壊しない事     | Not to be broken           |
| 2.出力がダウンしない事 | Not to be shut down output |
| 3.その他異常のない事  | No other out of orders     |

(5) 試験結果 Test Result

PAH300S24-12	合格 OK
PAH300S24-28	合格 OK

## 7. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test

MODEL : PAH300S24-28

## (1) 使用装置 Machine Used

自動はんだ付装置 (千住金属工業)

Automatic Dip Soldering Machine (Senju Metal Industry Co.,Ltd.)

## (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

## (3) 試験条件 Test Conditions

- ・ 溶融はんだ温度 : 260℃  
Dip Soldering Temperature
- ・ 浸漬保持時間 : 10秒  
Dip Time seconds
- ・ 予備加熱温度 : 110℃  
Pre-heating Temperature
- ・ 予備加熱時間 : 40秒  
Pre-heating Time seconds

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を基板にのせ、自動はんだ付装置でフラックス浸漬、予備加熱、はんだ付を行う。常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. on a circuit board, transfer to flux-dipping, pre-heat, and solder in the automatic dip soldering machine. Leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・ 試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 24VDC      出力電流 : 11A(100%)      ベースプレート温度 : 25℃  
Input Voltage      Output Current      Base-Plate Temperature

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.057	28.053
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	143.5	147.5
入力変動 Line Regulation	mV	11	5
負荷変動 Load Regulation	mV	1	1
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

## 8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : PAH300S24-28

### (1) 使用計測器 Equipment Used

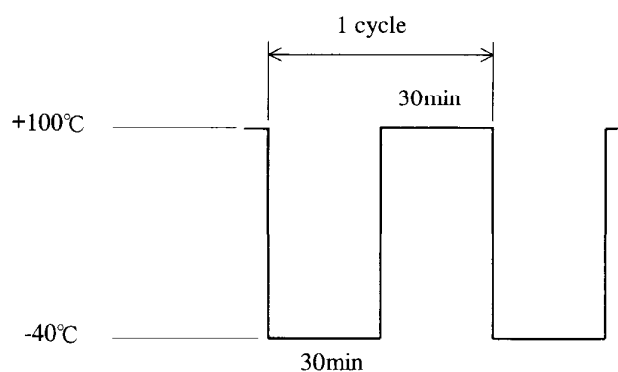
THERMAL SHOCK CHAMBER TSV-40 (TABAI ESPEC CORP.)

### (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

5 台 (units)

### (3) 試験条件 Test Conditions

- ・ 電源周囲温度 :  $-40^{\circ}\text{C} \longleftrightarrow +100^{\circ}\text{C}$   
Ambient Temperature
- ・ 試験時間 : 30min  $\longleftrightarrow$  30min  
Test Time



- ・ 試験サイクル : 100、200 サイクル  
Test Cycles 100, 200 cycles
- ・ 非動作  
Not Operating

### (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100、200 サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

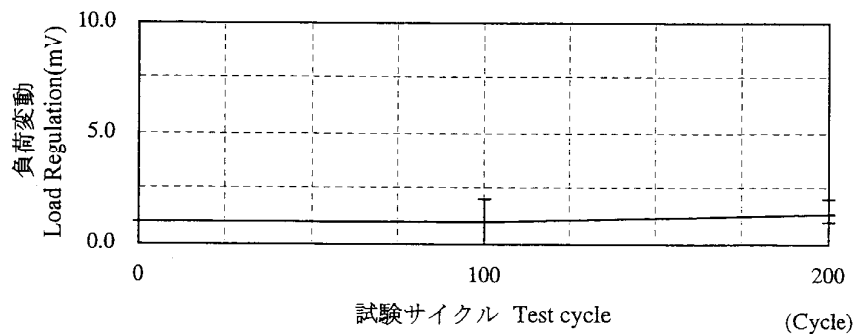
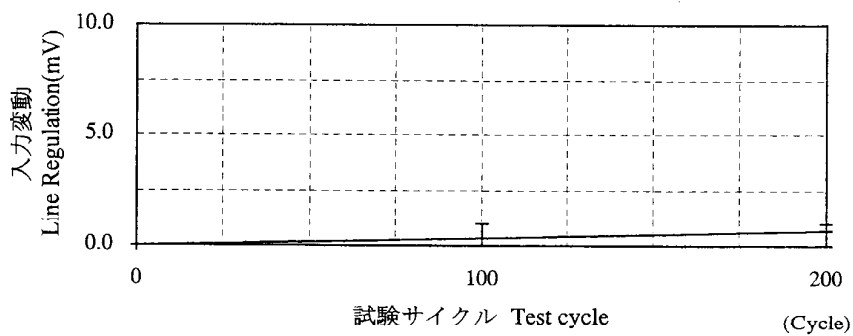
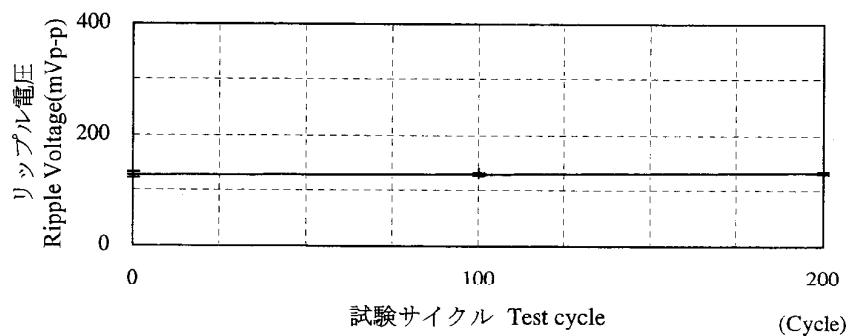
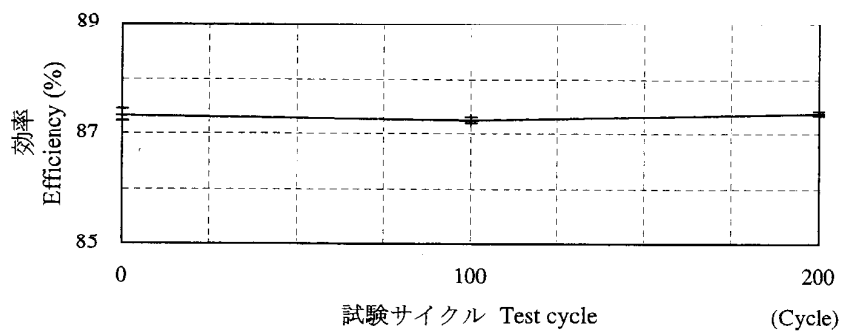
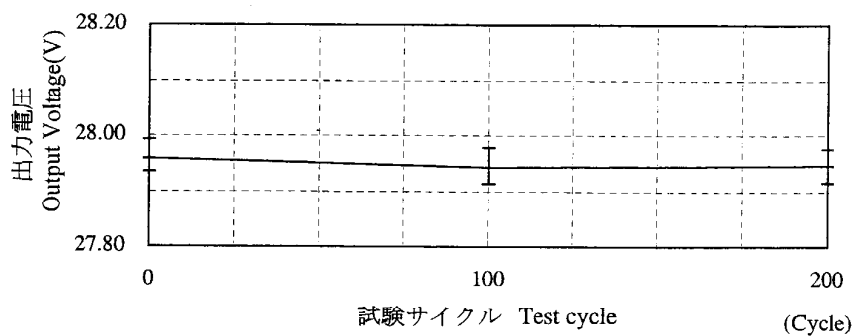
Before the test check if there is no abnormal output and put the D.U.T. in the testing chamber. Then test it in the above cycles. After the test is completed leave it for 1 hour at room temperature and check it if there is no abnormal output.

### (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

測定データは、次頁に示す。

See next page for measuring data.





## 9. 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test

MODEL : PAH300S24-28

## (1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.&amp; HUMID. CHAMBER SH-240SI (TABAI ESPEC CORP)

## (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

## (3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : 100°C      ・試験時間 : 100時間      ・非動作  
 Ambient Temperature      Test Time      hours      Not operating

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温 (25°C) から規定の温度 (100°C) まで徐々に上げる。供試品を規定温度で100時間放置し、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Leave the D.U.T. for 100 hours at 100°C and for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 24VDC      出力電流 : 11A(100%)      ベースプレート温度 : 25°C  
 Input Voltage      Output Current      Base-Plate Temperature

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.064	28.089
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	160.5	156.5
入力変動 Line Regulation	mV	7	5
負荷変動 Load Regulation	mV	4	1
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

1 0 . 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test

MODEL : PAH300S24-28

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER SH240-SI (TABAI ESPEC CORP)

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : -40°C      ・試験時間 : 100時間      ・非動作  
Ambicnt Temperature      Test Time      hours      Not operating

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温 (25°C) から規定の温度 (-40°C) まで徐々に下げる。供試品を規定温度で100時間放置し、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually decreased from 25°C to -40°C. Leave the D.U.T. for 100 hours at -40°C and for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 24VDC      出力電流 : 11A(100%)      ベースプレート温度 : 25°C  
Input Voltage      Output Current      Base-Plate Temperature

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.123	28.064
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	158.0	160.5
入力変動 Line Regulation	mV	15	7
負荷変動 Load Regulation	mV	10	4
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

## 1 1. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test

MODEL : PAH300S24-28

## (1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.&amp; HUMID. CHAMBER PSL-2SP (ESPEC CORP)

## (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

2 台 (units)

## (3) 試験条件 Test Conditions

・ 周囲温度 : 85℃ Ambient Temperature	・ 湿度 : 85%RH Humidity	・ 試験時間 : 500時間 Test Time
・ 入力電圧 : 24VDC Input Voltage	・ 出力電圧 : 定格 Output Voltage Rated	・ 出力電流 : 0A (0%) Output Current

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温 (25℃) から周囲温度が規定の温度 (85℃) になるまで徐々に上げる。供試品を規定の条件にて500時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25℃ to 85℃. Operate the D.U.T. for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・ 試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 24VDC

Input Voltage

出力電流 : 11A(100%)

Output Current

ベースプレート温度 : 25℃

Base-Plate Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.086	28.077	28.006	27.994
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	166.0	184.5	158.0	177.0
入力変動 Line Regulation	mV	4	3	2	9
負荷変動 Load Regulation	mV	1	1	2	1
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK